



kester®

Technical Data Sheet

1544 液态助焊剂

高活性松香型液态助焊剂

产品概述

Kester 1544是高品质酒精溶液体系溶入了WW 等级纯度的松香的具有高活性的松香型助焊剂.1544添加的高效的活化剂提供了优良的助焊性能. 1544是具有等价于Kester 44松香型焊材性能的液态助焊剂.助焊剂的活性强度以及松香残留物的量取决于固态物含量,1544的研发是为了能应用在无活性或者中等活性松香型助焊剂难以去除金属氧化物,避免腐蚀而需要完全彻底清除残留但水溶型有机酸难以实现,或者电子组装中需要立即润湿与良好毛细流动的领域.1544能用于裸线预上锡.

Performance Characteristics:

- 热稳定性高
- 改良的焊接性能
- 按照J-STD-004标准,定义为ROM1 型助焊剂

RoHS 认证

本产品符合RoHS指令,对于2015/863国家明令禁止的物质要求.

物理特性

比重: 0.917-0.928
Anton Paar DMA 35 @ 25°C

固态含量(理论值): 50%
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.34章节方法测试

闪点: 18°C (64°F)

挥发性有机化合物含量 (克/升): 459

可靠性

铜镜腐蚀: 适中
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.32章节方法测试

铬酸银实验: 未通过
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.33章节方法测试

氟化物点滴测试: 通过
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.35.1章节方法测试

铜腐蚀测试: 低
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.6.15章节方法测试

氯,溴检测: 0.44%
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.35章节方法测试

产品应用

1544能通过刷, 浸或波峰涂覆等方式使用

制程工艺管控

对于大多数电路板组装而言, 最适宜的预热温度为90-105°C (194-221°F), 此为上板面或元件表面测量的温度, 一般来说有铅合金要求焊点与波峰接触时间为2-4秒, 无铅合金焊接要求焊点与波峰接触时间为4-8秒. 波峰焊传输速度需要调整到能实现整个板能接触到波峰. 接下来就是调整温度设置实现整个电路板的上表面预热温度在预热区能达到要求值.

助焊剂控制

通常, 比重是控制高固态含量松香型助焊剂浓度的最可靠的方法。为了检查浓度, 应当使用到液体比重计. Kester 104稀释剂被用来稀释这种中等活性的松香型助焊剂到需要等固态含量浓度以及酸值, 同时也能补充溶剂因挥发而造成的损失. 1544的比重范围是0.917-0.928 (Anton Paar DMA @ 25°C).

清洗

Kester 1544残留是不导电的, 无腐蚀性, 在大多数应用的情况下无需清洗。若需要清洗, 请致电咨询Kester技术支持

存储和保存期限

Kester 1544 是易燃性的, 请远离火源存储。在10-25°C (50-77°F)条件下合理存储, 保存期限为2年

健康与安全

本产品在操作和使用过程中, 可能会对健康或环境造成危害。请在使用本产品前, 阅读材料安全说明书和警示标签。